

## 奇景光電宣布推出下一代雷射投影機的晶圓級光學鏡頭（WLO）雷射準直鏡

【台南，2016年1月4日】奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今天宣布，開發出包含繞射光學元件（**Diffraction Optics Element**，簡稱**DOE**）的晶圓級光學鏡頭（**Wafer Level Optics**，簡稱**WLO**）雷射準直鏡（**laser diode collimator**），使用於雷射投影機的下一代應用產品。此技術可顯著縮小雷射投影機體積，就如同**3D**掃描機，應用產品可支援智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、車用、擴增與虛擬實境及物聯網，提供使用者更多的全新體驗。奇景**WLO**雷射準直鏡應用於**3D**相機的新產品，預計在**2016**年第一季，將由奇景合作夥伴的客戶推出上市。

奇景的**WLO**採用獨特的複合光學系統、準直鏡及光學繞射元件組合而成高度小於**2**毫米的鏡頭。而**WLO**準直鏡可以堆疊在雷射的頂部上，包含極小化鏡頭和雷射投影機的組裝高度，可以下降到**5**毫米的高度。此微型**WLO**雷射準直鏡，提供了高定位精準度、準直鏡及**DOE**可客製化，滿足系統及演算的需求。

奇景光電執行長吳炳昌表示，自**2009**年以來，公司已提供大量**WLO**給領先的相機模組廠，終端客戶主要是頂級智慧型手機及相機**OEM**廠。奇景建置**WLO**的設計及製造技術，顯著縮小編碼雷射投影機的體積，進而降低成本。奇景目前已與多家主要**OEM**廠合作研發**WLO**新設計。使用在主動感測**3D**相機的編碼模式，奇景的**WLO**雷射準直鏡可以將雷射投影機的模組縮小至**1/9**，較傳統相機小的多，由於此優勢更容易使用在下一代的智慧型手機、平板電腦、車用、可穿戴裝置、物聯網應用、電腦配件及其他使用在消費、醫療及工業等新的應用。

奇景**WLO**雷射準直鏡及**DOE**，由奇景在台南的光學晶圓工廠生產製造，應用於**3D**相機的第一款新產品，將於**2016**年第一季由奇景合作夥伴的客戶推出問世。

### 關於奇景光電：

本公司係全球顯示器驅動 **IC** 與時序控制 **IC** 領先廠商，產品應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航以及其他多種消費性電子產品。奇景光電的其他產品並包含觸控面板控制 **IC**、手持式與頭戴式矽控液晶光閥（**LCOS**）微型投影解決方案、**LED** 驅動 **IC**、電源管理 **IC**、監視器及投影機控制晶片、客製化影像處理晶片解決方案及提供矽智權的授權等。奇景光電亦提供數位相機解決方案，包括 **CMOS** 影像感測 **IC** 及晶圓級鏡頭，這些產品已被廣泛地應用在手機、平板電腦、筆記型電腦、電視、網路攝影機、汽車、保全及醫療器材等。奇景光電設立於 **2001** 年，總部位於台灣台南，目前員工人數約 **1,900** 人，分布於台南、新竹、台北、中國、韓國、日本與美國。至 **2015** 年 **9** 月 **30** 日為止，奇景光電在全球已取得 **2,712** 項專利，尚有 **612** 項專利正在申請中，產品應用於全球各種消費性電子品牌產品，技術領先並維持影像顯示處理技術半導體解決方案領導廠商的地位。

### 聯絡人：

黃華珮 / Jessica Huang  
媒體關係 專案經理  
奇景光電股份有限公司  
Himax Technologies, Inc.  
+886-3-516-3276 分機 38817  
jessica\_huang@himax.com.tw

陳菝雅 / Nadiya Chen  
投資人關係 經理  
奇景光電股份有限公司  
Himax Technologies, Inc.  
+886-2-2370-3999 分機 22513  
nadiya\_chen@himax.com.tw

林佳慧 / Penny Lin  
投資人關係 經理  
奇景光電股份有限公司  
Himax Technologies, Inc.  
+886-2-2370-3999 分機 22320  
penny\_lin@himax.com.tw

### Investor Relations - US Representative

John Mattio, Founder  
Lamnia International, LLC.  
+1 (203) 885 -1098  
Direct: +1 (203) 885 -1058  
jmattio@lamniaintl.com  
www.lamniaintl.com

### 風險說明：

本新聞稿的部分展望未來的陳述，特別是有關於財務、產業預測，可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同，可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動 **IC** 產品及非驅動 **IC** 產品之接受度、產品競爭力、

市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才，包括本公司為 2014 年度所申報的 20-F 文件中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件，本公司皆無義務公開更新或修改此風險說明。